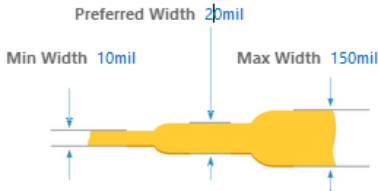

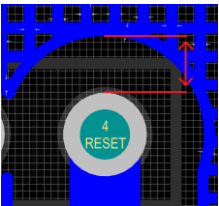
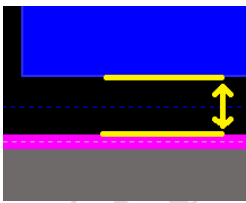

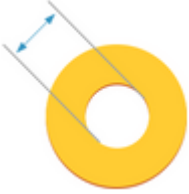
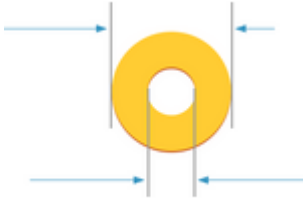

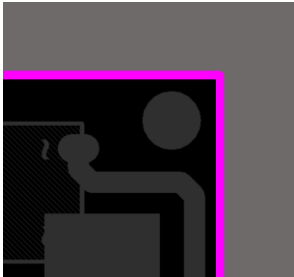
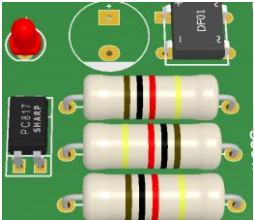
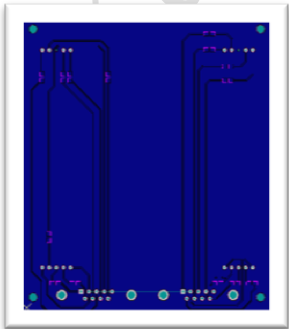
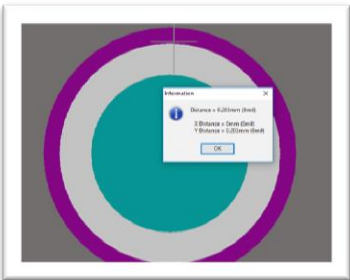


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NHẬN MẠCH

Hình Ảnh	Tiêu Chuẩn	Giá Trị
	Độ rộng đường mạch tối thiểu	10 mil (0.254 mm)
	Khoảng cách tối thiểu giữa 2 đối tượng: <ul style="list-style-type: none"> • Track to Track • Pad to Pad • Track to Via • Via to Via 	10 mil (0.254 mm)
	Khoảng cách từ chân linh kiện đến lớp phủ đồng.	Tối thiểu là: 20 mil (0.5 mm)
	Khoảng cách chừa đường biên. Hay Khoảng cách từ lớp phủ đến mép PCB	≥ 20 mil (0.5mm)
	Khoảng cách giữa chân linh kiện và lớp phủ mạch.	Nhỏ nhất : 4mil (0.102 mm)

	<p>Kích thước lỗ khoan (chân linh kiện)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chân linh kiện (mm) : 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 Lỗ bắt vít (mm) : 3.0, 3.5, 4.0, 5.0
	<p>Kích thước lỗ via (Kết nối 2 lớp Top với Bot)</p>	<p>Nhỏ nhất : 16 mil (0.4mm)</p>
	<p>Độ dày của chữ trên lớp Bot và Top</p>	<p>Nét khung in linh kiện 0.3mm Nét chữ linh kiện cao 2mm, nét chữ 0.18mm Tên mạch cao 2.5mm, nét chữ 0.15mm</p>
	<p>Đường Bao Mạch (Keep Out Layer)</p>	<p>Bắt buộc có đường bao mạch.</p>
	<p>Xác định mặt cắm linh kiện và mặt hàn linh kiện đối với mạch in 1 lớp.</p>	
	<p>Kích thước tối đa của bản mạch</p>	<p>1 lớp : 28*19cm 2 lớp : 28*19cm</p>

	Khoảng cách lỗ via với pad	Khoảng cách tối thiểu 8mil (0.203)
---	----------------------------	---------------------------------------

Đối với lỗ khoan khi các bạn thiết kế phải loại trừ ra sai số, vì đối với mạch 2 lớp chúng tôi có mạ xuyên lỗ, lớp mạ này sẽ làm cho lỗ khoan nhỏ hơn thực tế. Ví dụ khoan lỗ khoan 0.8 thì thực tế khoảng 0.75mm. Đặt càng ít loại lỗ khoan càng tốt, không đặt lỗ khoan trùng nhau.